

Rework SMD e BGA - Le tecniche

Prezzo: 12.90 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 12.90 €



Conoscere i componenti e le tecniche di montaggio superficiale è diventato sempre più importante, perché la gran parte dei circuiti elettronici odierni fa uso di elementi SMD e circuiti integrati ad elevata scala di integrazione, che in futuro tenderanno ad essere sempre più miniaturizzati. I circuiti stampati divengono così sempre più compatti e i componenti vicini, minuscoli e con terminali difficilmente accessibili, il che rende la riparazione o la costruzione dei PCB decisamente ardua, tanto che i tradizionali attrezzi da laboratorio, come il comune saldatore e il filo di lega saldante in molti casi divengono inadeguati. Questo volume introduce la tecnica SMT e le metodiche di montaggio, sostituzione e rework dei componenti elettronici SMD, spiegando quali sono e come si usano le moderne attrezzature richieste in un laboratorio che voglia essere al passo con i tempi; attrezzature che non sono necessariamente diverse, ma in qualche caso solo più piccole e adatte alla gestione dei componenti a montaggio superficiale. Ma anche strumenti e apparati dedicati al montaggio e al rework degli SMD, come le stazioni saldanti e dissaldanti a stilo e quelle a getto d'aria calda (Hot-Air Station) nonché le macchine per il rework dei circuiti contenenti componenti in package BGA. Verranno introdotte tecniche dedicate ai componenti LGA e BGA, come il reflow e il reballing, descrivendo le attrezzature e l'utilizzo delle macchine richieste, senza dimenticare qualche suggerimento pratico per operare con componentistica molto complessa senza dover necessariamente acquistare macchine professionali e inevitabilmente costose.

Contenuti

- LA TECNICA SMT
- PACKAGE SMD
- IL LABORATORIO
- LAVORAZIONI SUGLI SMD
- REWORK DEGLI INTEGRATI
- REWORK DEI BGA

Informazioni aggiuntive

- **Autore:** Davide Scullino
- **Pagine:** 122
- **Dimensioni (mm):** 240x170x8
- **Peso:** 276 grammi